

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年9月19日(19.09.2024)



(10) 国際公開番号

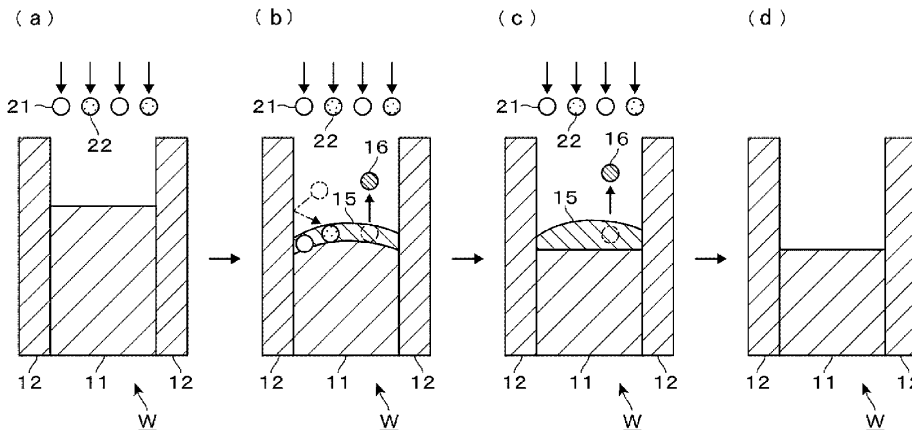
WO 2024/190153 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/3065 (2006.01) H01L 21/302 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/003640
- (22) 国際出願日: 2024年2月5日(05.02.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-038892 2023年3月13日(13.03.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 鄭 雄 鉉 (JEUNG Woonghyun); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650

- 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP). 浅田 泰生 (ASADA Yasuo); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP). 旭 健史郎 (ASAHI Kenshiro); 30078 新竹市新竹科学工業園区篤行路7号 東京エレクトロン台湾株式会社内 Hsin-chu (TW).
- (74) 代理人: 弁理士法人弥生特許事務所(YAYOY PATENT OFFICE); 〒2310058 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目15番1号ストークタワー大通り公園3601号 Kanagawa (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

(54) Title: ETCHING METHOD AND ETCHING DEVICE

(54) 発明の名称: エッチング方法及びエッチング装置



(57) Abstract: An etching method according to the present disclosure includes an etching step in which a halogen-containing gas, an ammonia gas, and an amine gas are supplied as etching gases to a substrate having a silicon oxide film formed on the surface thereof, and the silicon oxide film is etched.

(57) 要約: 本開示のエッチング方法は、表面に酸化シリコン膜が形成された基板に、ハロゲン含有ガスと、アンモニアガスと、アミンガスとをエッチングガスとして供給して、前記酸化シリコン膜をエッチングするエッチング工程を含む。

[続葉有]

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))